



专注工业自动化

佛山市佛大华康科技有限公司

销售经理：卢建荣 手机：13929965158

销售经理：刘荣富 手机：13929965156

网址：www.gcrobot.net

地址：佛山市南海区桂城简平路1号天安科技大厦1305



专注工业自动化



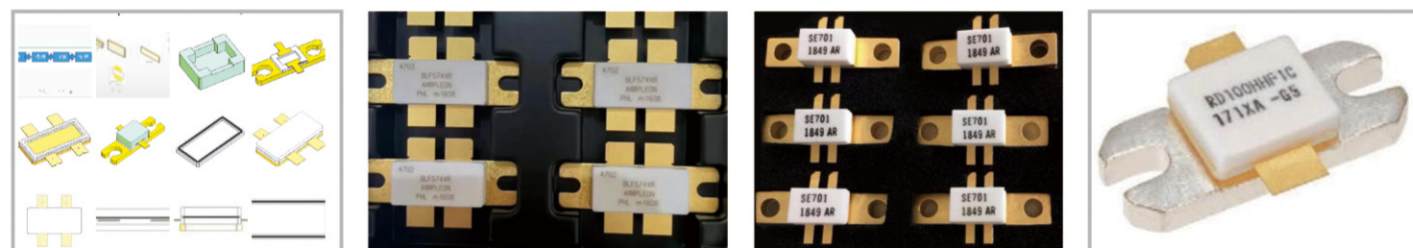
半导体芯片管壳 等温恒温封装机



高性价比封装方案

- ▶ 佛大华康科技是Air Gavity Plastic (ACP空腔塑料)封装业界的领导者, 封装低成本、高性能。
- ▶ 提供完整方案:ACP空腔封装设计、材料开发、定制密封工艺、B-级胶
- ▶ 更好的改良性能:热性能(30%) , 提高频率(2x)
- ▶ 可以应用在所有频率&功率段
- ▶ 可根据客户需求特殊定制

封装器件



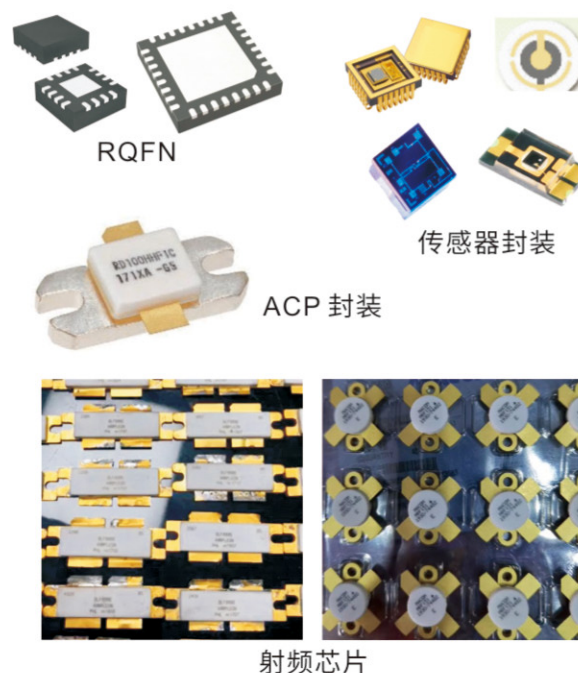
- ▶ 更少的成本需求
- ▶ 最优化成本结构
- ▶ 可用铜基座
- ▶ 最好的瓦/\$比值
- ▶ 更好的散热性能

主要市场应用

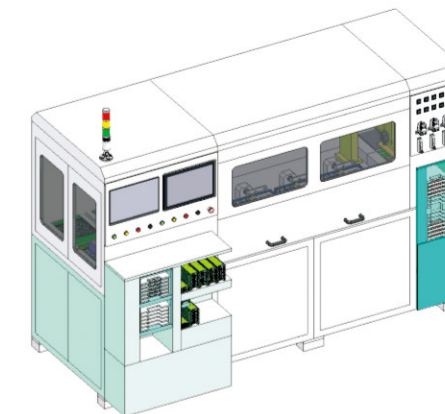
- RF 功率 (基站)**
- ▶ 民用市场, 全自动经济RF快速封装生产线
 - ▶ RF功率市场正处于向铜热基转变的拐点
 - ▶ 设计灵活, 方便快速响应市场
 - ▶ 更高性能封装需求, LDMOS的改进已经到了极限
 - ▶ RF能源方面经济有效的封装需求

- 无线**
- ▶ 更高频率的终端应用
 - ▶ 更好的热性能

- 医疗**
- ▶ 可靠的起搏器定制封装
 - ▶ 用于辐射传感器的导电高分子材料



半自动等温封装机

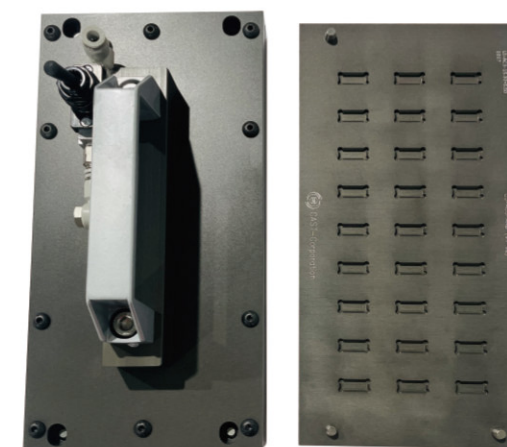


全自动芯片管壳封装设备

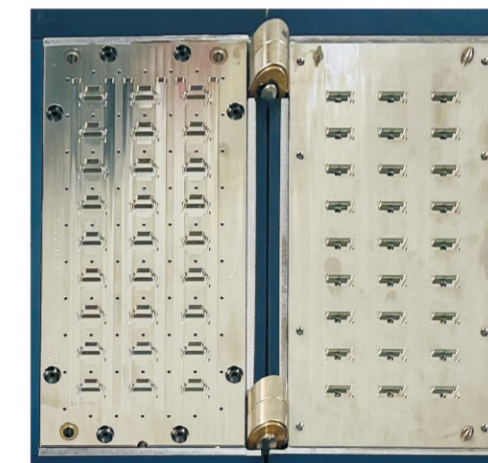
- ▶ 全自动、半自动封装恒温等温设备
- ▶ 半自动、全自动工艺密封解决方案
- ▶ 陶瓷盖或树脂盖封装
- ▶ 环氧树脂和聚合物材料开发
- ▶ 空腔管壳设计和工艺开发
- ▶ 提供精密管壳、带胶树脂盖、芯片管壳封装设备和工艺整体解决方案, 提高芯片一致性和成品率
- ▶ 独特的专利技术&软件控制技术, 有效优化溢胶、炸胶、漏气等问题, 提高封装芯片的一致性和成品率高。

应用场合

RF功率(基站)、民用市场基站配套器件、更高频率的终端应用、射频与微波、电源管理、放大器、电机驱动器、逻辑电压转换、隔离、接口、数据转换、时钟和计时、音频、放大器、传感器、开关与多路复用器、无线连接等芯片管壳封装。



定制封装机：上盖中转治具



定制封装机：管壳模具

HK-MOLD-L&B 芯片封合模具